

## 描述

HM8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HM8833有两路H桥驱动，可以驱动两路刷式直流电机，或者一个双极步进电机，或者螺线管或者其它感性负载。

每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成，叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。

内部关断功能包含过流保护，短路保护，欠压锁定保护和过温保护，并提供一个错误输出管脚。

HM8833提供三种封装，一种是带有裸露焊盘的TSSOP-16封装，另一种是带裸焊盘的QFN16封装，能有效改善散热性能，且是无铅产品，引脚框采用100%无锡电镀。还有一种封装为SOP16，不带裸露焊盘。

## 应用

- 锂电池供电玩具
- POS 打印机
- 安防相机
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 机器人

## 型号选择

产品型号	封装	包装
HM8833MTE	TSSOP16-PP	料管, 60颗/管
HM8833SQ	QFN16-PP	编带, 5000颗/盘
HM8833SP	SOP16	料管, 50颗/管

## 特点

- 双通道H桥电流控制电机驱动器
- 驱动两路直流电机或者一个步进电机
- 低RDS(ON)电阻
- 1.5A驱动输出 (TSSOP16、QFN16封装)
- 1.4A驱动输出 (SOP16封装)
- 输出可以并用，最大提供3A驱动输出
- 宽电压供电, 2.7V-15V
- PWM电流整流/限流
- 过温关断电路
- 短路保护
- 欠压锁定保护

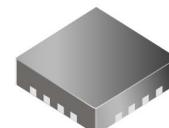
## 封装形式



SOP16

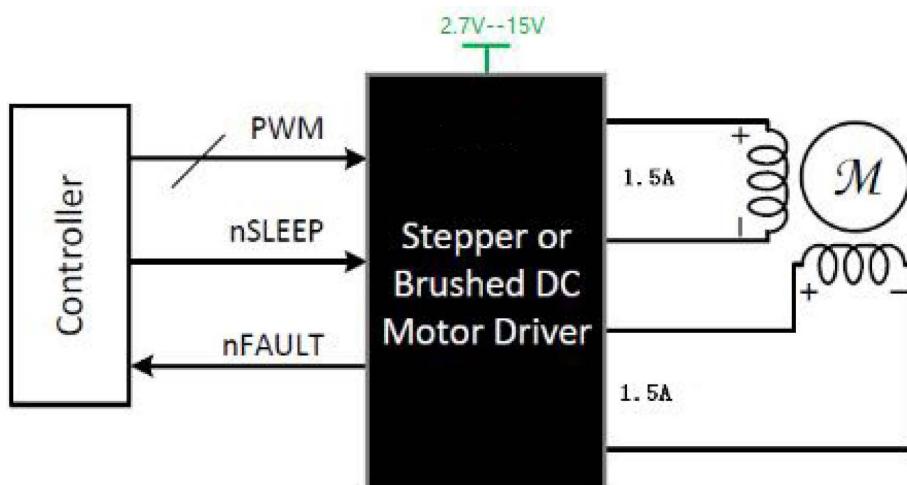


TSSOP16

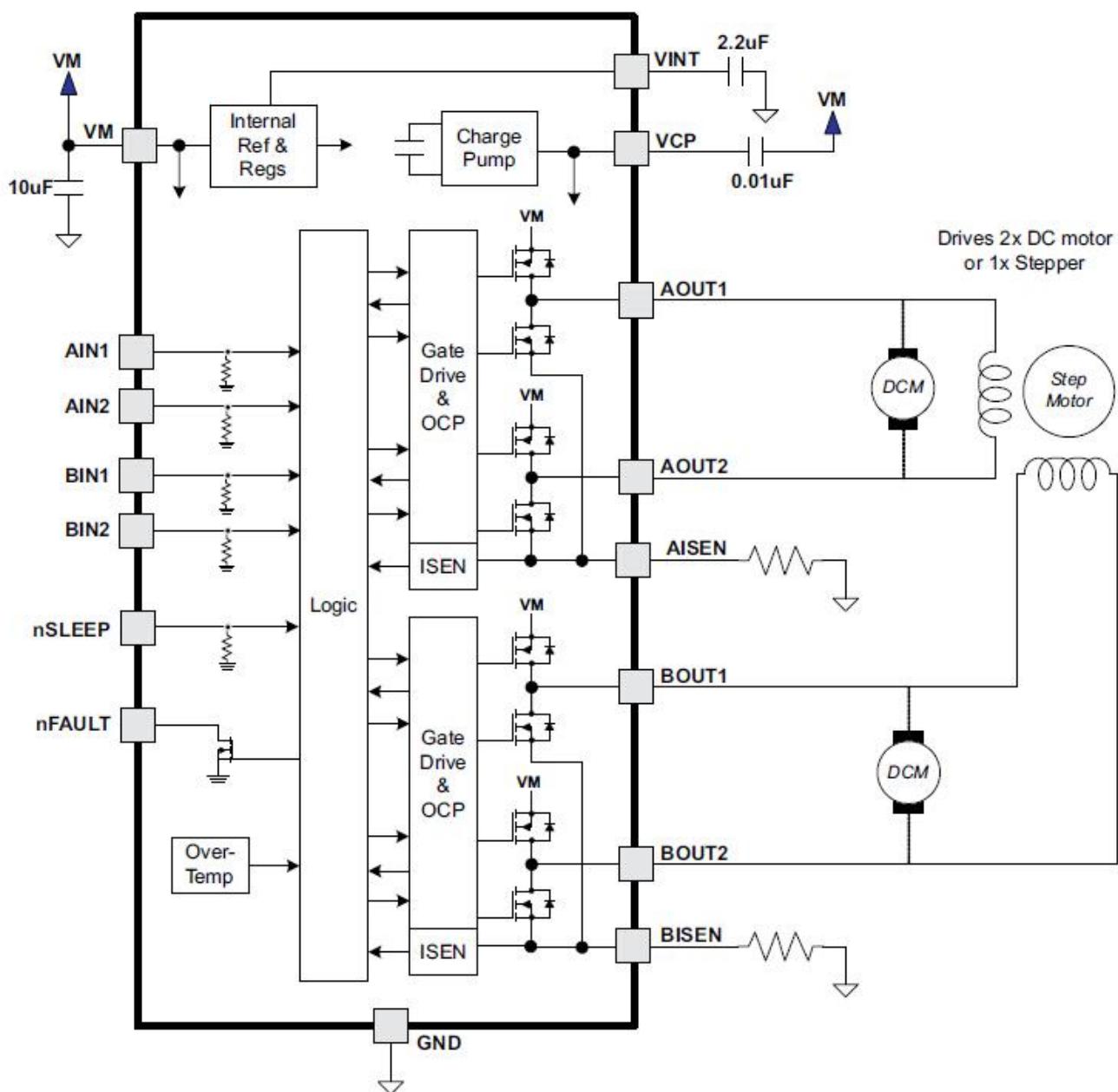


QFN16

## 典型应用原理图



功能结构框图



电路工作极限 at Ta = 25°C

Parameter	Symbol	Conditions	Ratings	Unit
负载电压	V <sub>M</sub>		-0.3 – 16	V
持续输出电流	I <sub>OUT</sub>		±1.5	A
瞬间峰值电流	I <sub>PEAK</sub>		>2.5	A
逻辑输入电压	V <sub>IN</sub>		-0.7 to 7	V
Sense 电压	V <sub>SENSE</sub>		-0.3 to 0.5	V
工作温度	T <sub>A</sub>	Range S	-40 to 85	°C
最大结温	T <sub>J(max)</sub>		150	°C
存储温度	T <sub>stg</sub>		-55 to 150	°C

推荐工作条件 at Ta = 25°C

		Min	NOM	Max	Unit
负载供电电压范围	V <sub>M</sub>	2.7	-	15	V
逻辑输入电压范围	V <sub>IN</sub>	0	-	5.75	V
单路 H 桥 RMS 输出电流	I <sub>OUT</sub> (TSSOP、QFN)	0		1.5	A
	I <sub>OUT</sub> (SOP)	0		1.4	

注意 1，HM8833 最大供电电压为 15V，此电压是针对步进电机的应用。如使用在直流电机应用方案中，请控制 V<sub>M</sub> 电压在 10.8V 以下。

注意 2，目前HM8833 提供三种封装，TSSOP16、QFN 封装的最大持续输出电流为 1.5A，SOP16 封装的最大持续输出电流为 1.4A，使用时请注意控制电流。另外，SOP16 与 TSSOP16-PP 封装在管脚定义上也有区别，请制板时特别注意，管脚具体定义请参考本文档第 12 页。

电特性 at  $T_a = 25^\circ\text{C}$ ,  $\text{VM} = 5\text{ V}$

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
<b>POWER SUPPLY</b>						
IVM	VM 静态电流	$\text{VM} = 5\text{ V}$ , $\text{xIN1} = 0\text{ V}$ , $\text{xIN2} = 0\text{ V}$		1.7	3	mA
IVMQ	VM 休眠电流	$\text{VM} = 5\text{ V}$		1.6	2.5	uA
VUVLO	VM 欠压阈值	$\text{VM}$ falling			2.6	V
VHYS	VM 欠压迟滞			500		mV
<b>LOGIC-LEVEL INPUTS</b>						
VIL	逻辑输入低电平	nSLEEP			0.5	V
		All other pins			0.7	
VIH	逻辑输入高电平	nSLEEP	2.5			V
		All other pins	2			
VHYS	逻辑输入迟滞			0.4		V
RPD	输入内部下拉电阻	nSLEEP		500		kΩ
		All except nSLEEP		150		
IIL	输入低电平电流	$\text{VIN} = 0$			1	uA
IIH	输入高电平电流	$\text{VIN} = 3.3\text{ V}$ , nSLEEP		6.6	13	uA
		$\text{VIN} = 3.3\text{ V}$ , all except nSLEEP		16.5	33	
tDEG	防消抖时间			450		ns
<b>nFAULT OUTPUT (OPEN-DRAIN OUTPUT)</b>						
VOL	输出低电平	$\text{IO} = 5\text{ mA}$			0.5	V
IOH	关断漏电流	$\text{VO} = 3.3\text{ V}$			1	uA
<b>H-BRIDGE FETS</b>						
RDS(ON)	H 桥高侧 FET 导通电阻	$\text{VM} = 5\text{ V}$ , $\text{IO} = 500\text{ mA}$		200		mΩ
		$\text{VM} = 2.7\text{ V}$ , $\text{IO} = 500\text{ mA}$		250		
	H 桥低侧 FET 导通电阻	$\text{VM} = 5\text{ V}$ , $\text{IO} = 500\text{ mA}$		180		
		$\text{VM} = 2.7\text{ V}$ , $\text{IO} = 500\text{ mA}$		220		
IOFF	关断漏电流	$\text{VM} = 5\text{ V}$ , $\text{VOUT} = 0\text{ V}$	-1		1	uA
<b>MOTOR DRIVER</b>						
fPWM	电流控制 PWM 频率	Internal PWM frequency		50		kHz

tR	输出上升时间	VM =5V, 16Ω to GND, 10% to 90%		240		ns
tF	输出下降时间	VM =5V, 16Ω to GND, 10% to 90%		200		ns
tPROP	INx to OUTx 延迟	VM = 5 V		0.9		us
tDEAD	死区时间	VM = 5 V		340		ns

### PROTECTION CIRCUITS

IOCP	过流保护阈值		2.5			A
tDEG	过流延迟时间			2.25		us
tOCP	过流保护重启时间			1.35		ms
tTSD	过温阈值	Die temperature	150	160	180	°C

### CURRENT CONTROL

VTRIP	xISEN 封装电压		160	200	240	mV
tBLANK	blanking 时间			2.6		us

### SLEEP MODE

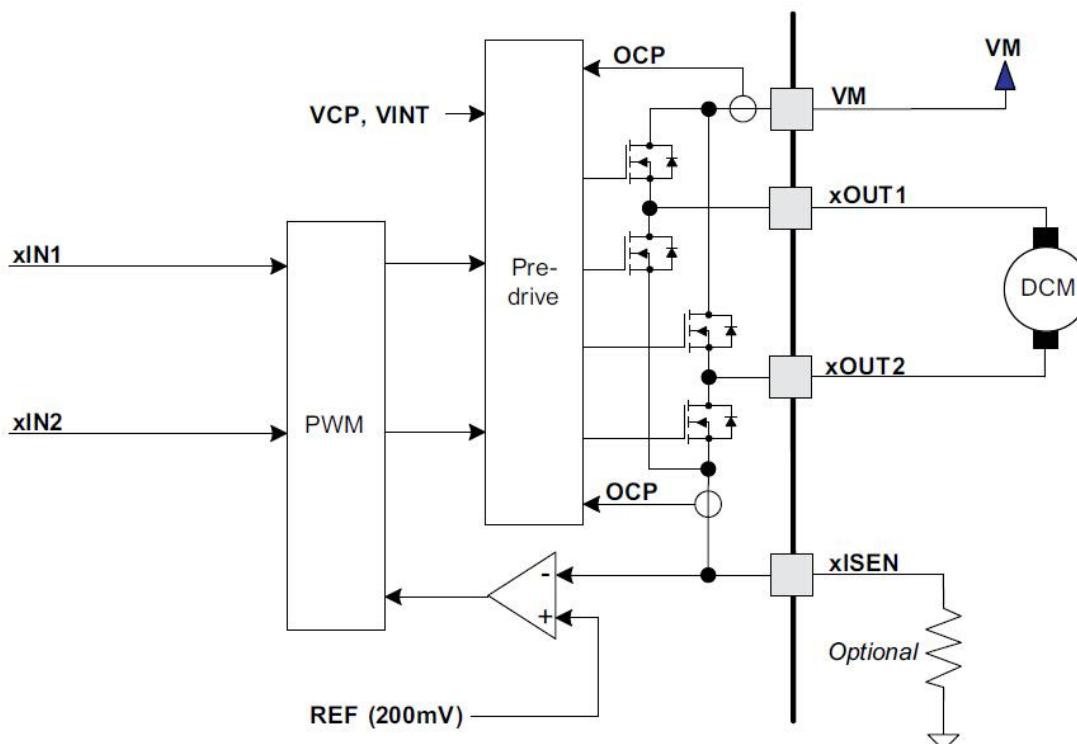
tWAKE	开启延迟时间	nSLEEP inactive high to H-bridge on		0.2	1	ms
-------	--------	-------------------------------------	--	-----	---	----

## 模块功能描述

HM8833 为刷式直流电机或者步进电机提供一种集成的驱动方案。芯片内部集成双通道 H 桥和整流电路。HM8833 的供电范围为 2.7V 到 15V，并提供 1.5A (TSSOP16-PP、QFN16-PP) 或者 1.4A (SOP16) 的连续输出。简单的 PWM 接口允许简单的接口控制电路。内部整流电路的周期时间为 20us。HM8833 还包含一个低功耗睡眠模式，允许不需要驱动芯片的时候节省功耗。

### PWM Motor Drivers

HM8833 包含两路 H 桥电机驱动电路，使用 PWM 电流控制。下图显示电路功能模块：



H-Bridge and Current-Chopping Circuitry

### Bridge Control and Decay Modes

输入管脚 AIN1 和 AIN2 控制着输出管脚 AOUT1 和 AOUT2 的状态。类似的，输入管脚 BIN1 和 BIN2 控制着输出管脚 BOUT1 和 BOUT2 的状态。下表显示了彼此间的逻辑关系。

xIN1	xIN2	xOUT1	xOUT2	FUNCTION
0	0	Z	Z	Coast / fast decay
0	1	L	H	Reverse
1	0	H	L	Forward
1	1	L	L	Brake / slow decay

H-Bridge Logic

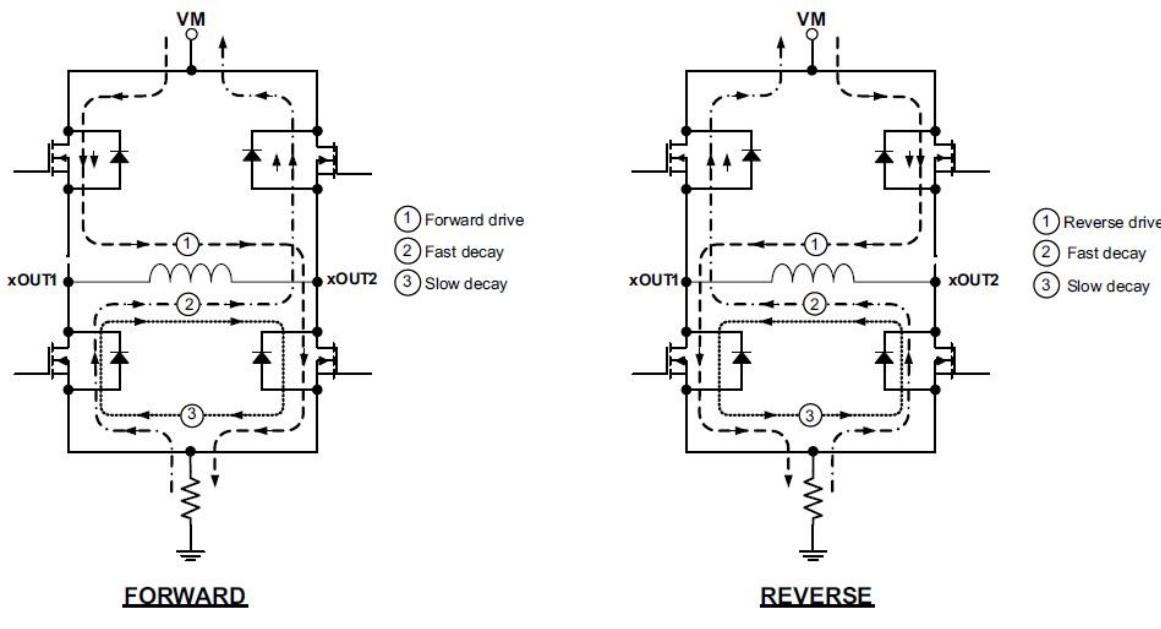
逻辑输入也可以使用 PWM 控制来达到调速功能。当用 PWM 波控制一个桥臂时，并且在驱动电流为关断时，由于电机的电感特性要求电流连续流通。这个电流叫做续流。为了操作这种电流，H 桥可以操作在两种不同的状态，快衰减或者慢衰减。在快衰减模式，H 桥是被禁止的，续流电流流经体二极管；在慢衰减模式，电机的下臂是短路的。

当 PWM 控制用于快衰模式，PWM 信号控制一个 xIN 管脚，而另一个管脚维持低电平；当运用于慢衰减，另一管脚维持高电平。

PWM Control of Motor Speed

xIN1	xIN2	FUNCTION
PWM	0	Forward PWM, fast decay
1	PWM	Forward PWM, slow decay
0	PWM	Reverse PWM, fast decay
PWM	1	Reverse PWM, slow decay

下图显示了在不同驱动和衰减模式下的电流通路。



Drive and Decay Modes

## Current Control

通过固定频率的 PWM 电流整流器，流过电机驱动桥臂的电流是被限制的或者是被控制的。在 DC 电机应用中，电流控制功能作用于限制开启电流和停转电流。在步进电机应用中，电流控制功能始终存在。

当一个 H 桥被使能，流过相应桥臂的电流以一个斜率上升，此斜率由直流电压 VM 和电机的电感特性决定。当电流达到设定的阈值，驱动器会关闭此电流，直到下一个 PWM 循环开始。注意，在电流被使能的那一刻，xISEN 管脚上的电压是被忽略的，经过一个固定时间后，电流检测电路才被使能。这个消隐时间一般固定在 2.6us。这个消隐时间同时决定了在操作电流衰减时的最小 PWM 时间。

PWM 目标电流由比较器比较连接在 xISEN 管脚上的电流检测电阻上的电压和一个参考电压决定。这个参考电压 VTRIP 一般固定是 200mV。下公式计算目标电流：

$$I_{CHOP} = \frac{200 \text{ mV}}{R_{XISEN}}$$

举个例子：假如使用了一个  $1\Omega$  的电阻，这样目标电流为 200mA。

注意：假如电流控制功能不需要使用，xISEN 管脚需直接接地。

## nSLEEP Operation

当驱动 nSLEEP 管脚为低时，会使芯片进入低功耗睡眠模式。在这个状态下，H 桥是被禁止的，电荷泵停止工作，内部所有逻辑被复位，内部所有时钟停止。所有输入被忽略直到 nSLEEP 管脚被拉高。当睡眠模式消除后，需要一些时间（一般 1ms）延时，电机驱动才会正常工作。为了简化板级设计，nSLEEP 管脚可以上拉到 VM。在这种情况下，推荐使用一个上电阻。这个电阻限制输入电流当 VM 大于 6.5V 时。nSLEEP 管脚内部下拉 500kΩ 电阻到地，同时内部还有一个 6.5V 的齐纳钳位二极管。当电流大于 250uA 时，可能会损坏内部输入结构。因此，推荐上拉电阻阻值一般在 20kΩ 到 75kΩ 之间。

## 保护电路

HM8833 有过流保护，过温保护和欠压保护。

### 过流保护 (OCP)

在每一个 FET 上有一个模拟电流限制电路，此电路限制流过 FET 的电流，从而限制门驱动。如果此过流模拟电流维持时间超过 OCP 脉冲时间，H 桥内所有 FET 被禁止，nFAULT 管脚输出低电平。经过一个 OCP 尝试时间 (tOCP)，驱动器会被重新使能，同时 nFAULT 管脚输出高电平。如果这个错误条件仍然存在，上述这个现象重复出现。如果此错误条件消失了，驱动恢复正常工作，但 nFAULT 管脚仍然被拉低。注意，只有被检测到过流的 H 桥会被禁止，而其余 H 桥仍是正常工作的。

H 桥上臂和下臂上的过流条件是被独立检测的。对地短路，对 VM 短路，和输出之间短路，都会造成过流关闭。注意，过流保护不使用 PWM 电流控制的电流检测电路，所以过流保护功能不作用与 xISEN 电阻。

### 过温保护 (TSD)

如果结温超过安全限制阈值，H 桥的作用 FET 被禁止，nFAULT 管脚输出低电平。一旦结温降到一个安全水平，所有操作会自动恢复正常。

### 欠压锁定保护(UVLO)

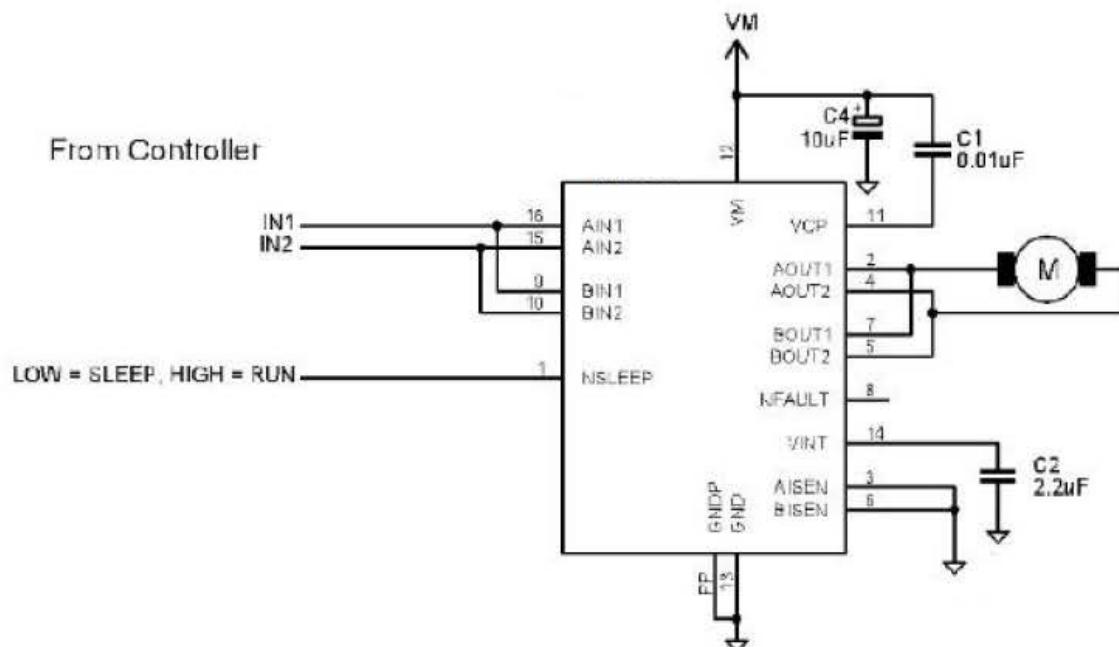
在任何时候，如果 VM 管脚上的电压降到低于欠压锁定阈值，内部所有电路会被禁止，内部所有复位。当 VM 上的电压上升到 UVLO 以上，所有功能自动恢复。nFAULT 管脚输出低电平当欠压情况出现时。

## 电路应用信息

### 复用输出模式

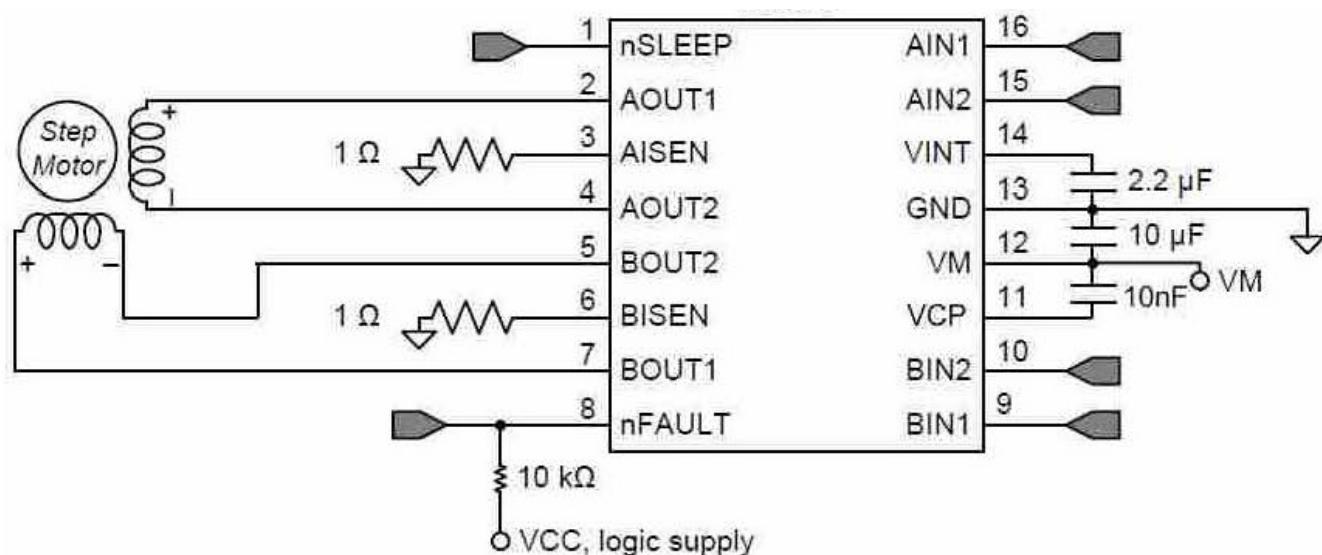
HM8833 的两路 H 桥可以接在一起并行输出，这样输出电流是单路 H 桥的两倍。HM8833 内部死区时间阻止两个 H 桥之间的任何交越导通冒险，此交越导通由两个 H 桥的时序存在差异造成。下图显示了并行输出连接。

注意，以下典型原理图和 PCB 布局图均以 TSSOP16 封装为例。

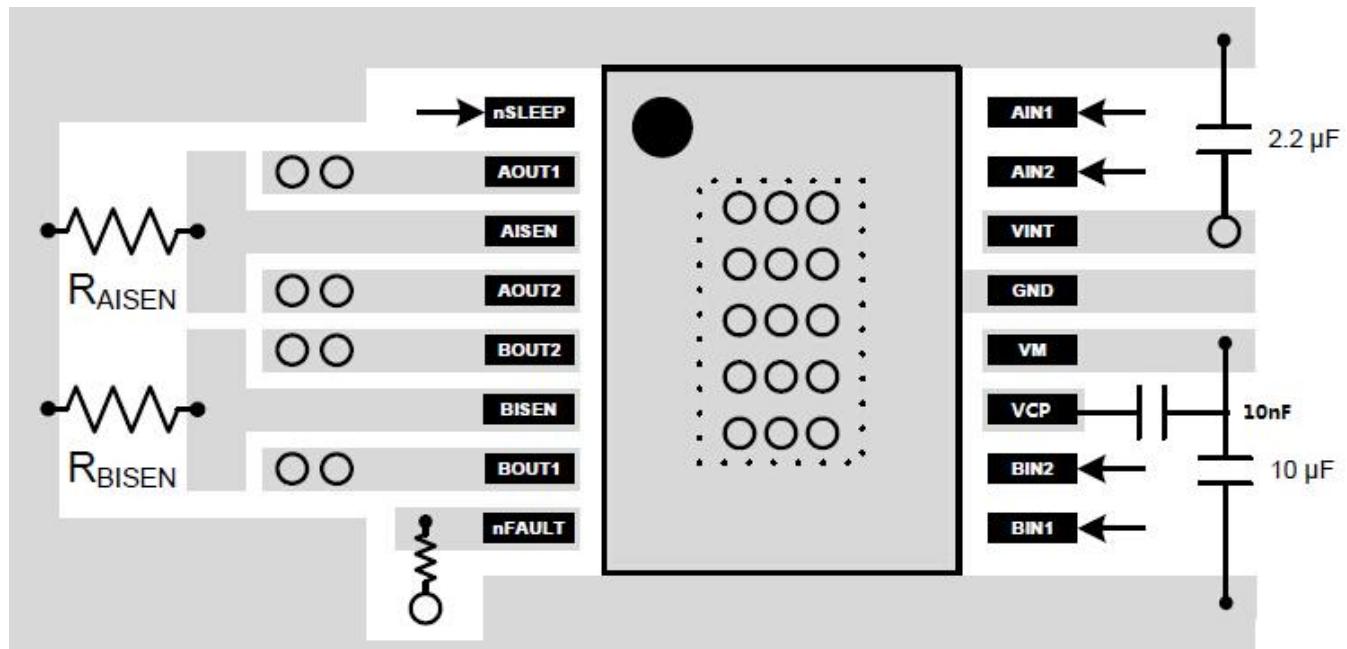


Parallel Mode

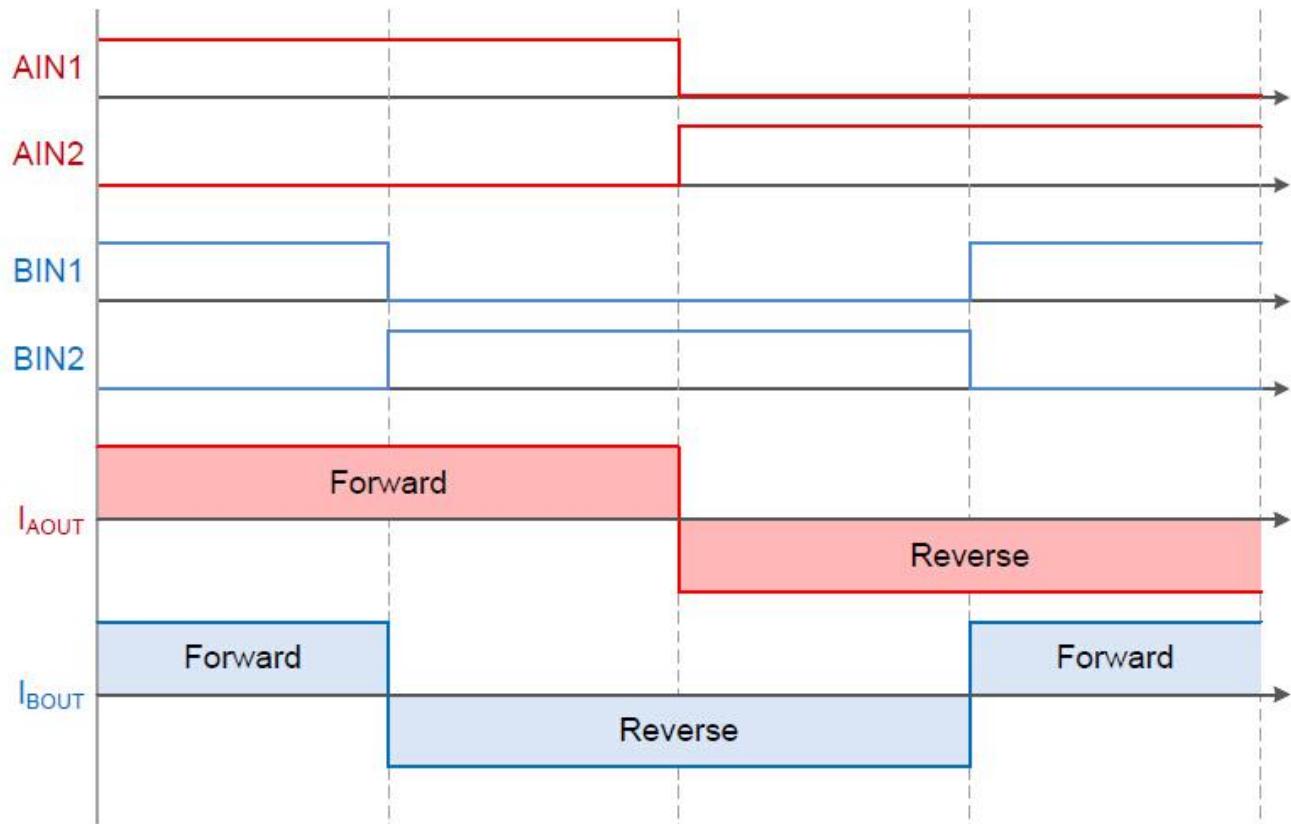
### 双极步进电机模式



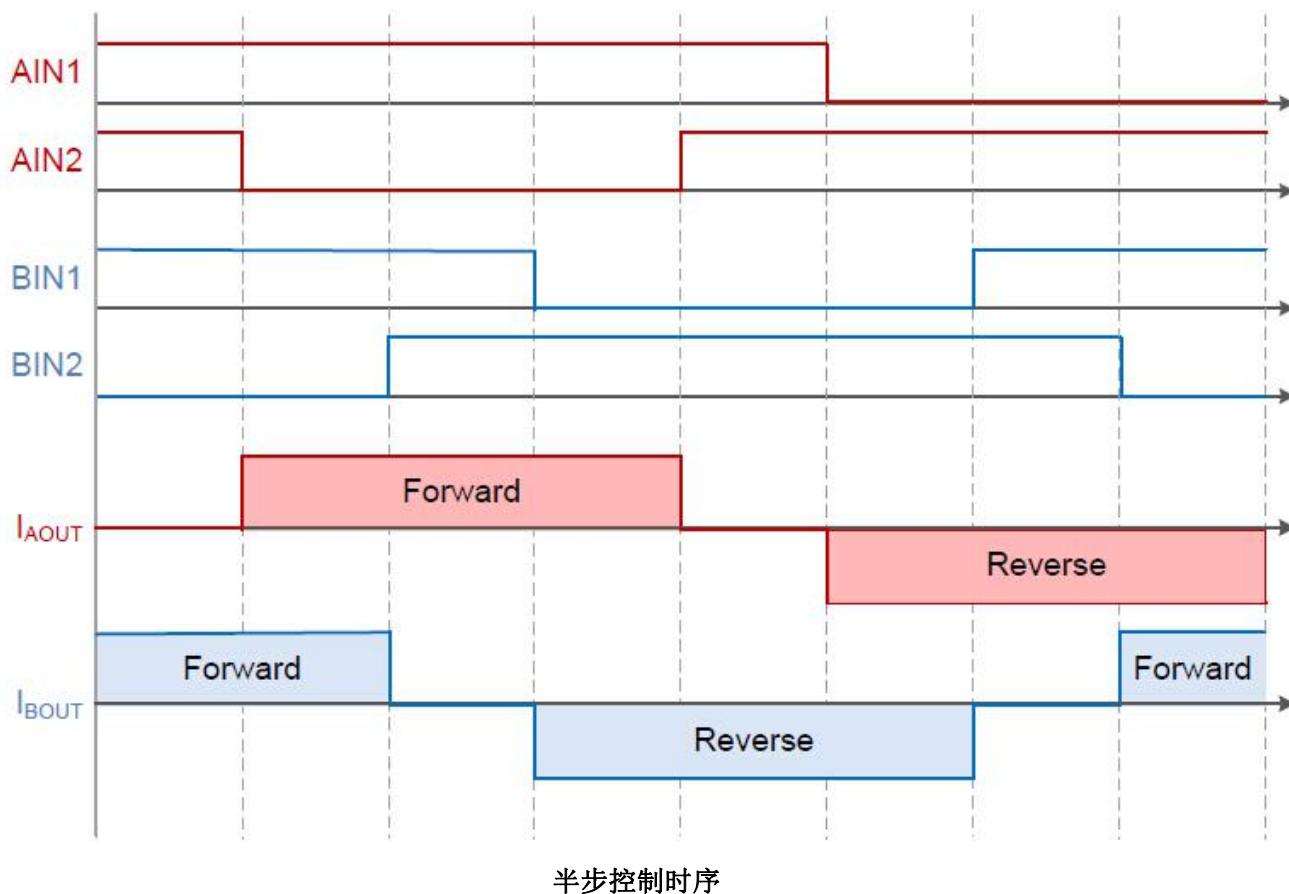
典型原理图



典型 PCB 布局图



整步控制时序



## 版图注意事项

PCB 板上应覆设大块的散热片，地线的连接应有很宽的地线覆线。为了优化电路的电特性和热参数性能，芯片应该直接紧贴在散热片上。

对电极电源 VM，应该连接不小于 10uF 的电解电容对地耦合，电容应尽可能的靠近器件摆放。

为了避免因高速 dv/dt 变换引起的电容耦合问题，驱动电路输出端电路覆线应远离逻辑控制输入端的覆线。

逻辑控制端的引线应采用低阻抗的走线以降低热阻引起的噪声。

## 地线设置

芯片所有的地线都应连接在一起，且连线还应改尽可能的短。一个位于器件下的星状发散的地线覆设，将是一个优化的设计。

在覆设的地线下方增加一个铜散热片会更好的优化电路性能。

## 电流取样设置

为了减小因为地线上的寄生电阻引起的误差，马达电流的取样电阻 RS 接地的地线要单独设置，减小其他因素引起的误差。单独的地线最终要连接到星状分布的地线总线上，该连线要尽可能的短，对小阻值的 Rs，由于 Rs 上的压降 V=I\*Rs 为 0.2V，PCB 上的连线压降与 0.2V 的电压将显得不可忽视，这一点要考虑进去。

PCB 尽量避免使用测试转接插座，测试插座的连接电阻可能会改变 Rs 的大小，对电路造成误差。Rs 值的选择遵循下列公式：

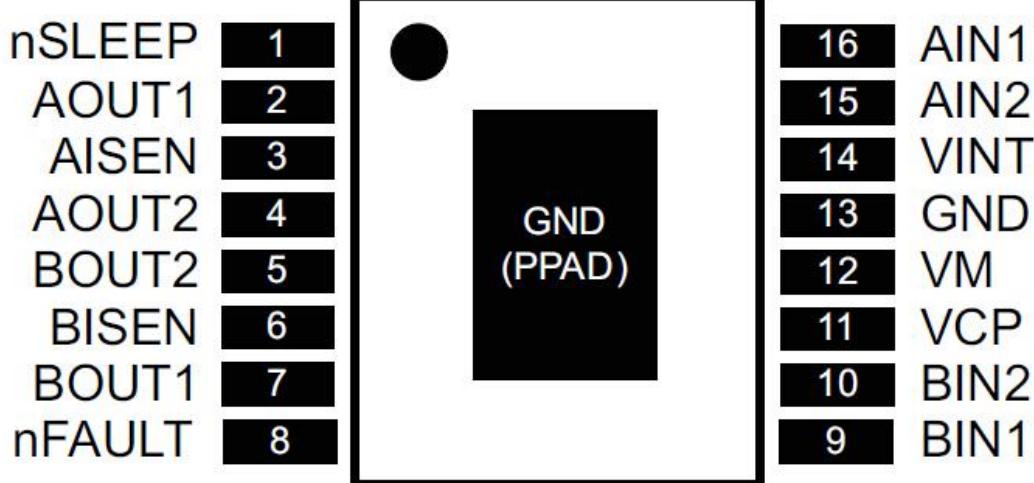
$$R_s = 0.2 / I_{TRIP\ max}$$

## 热保护

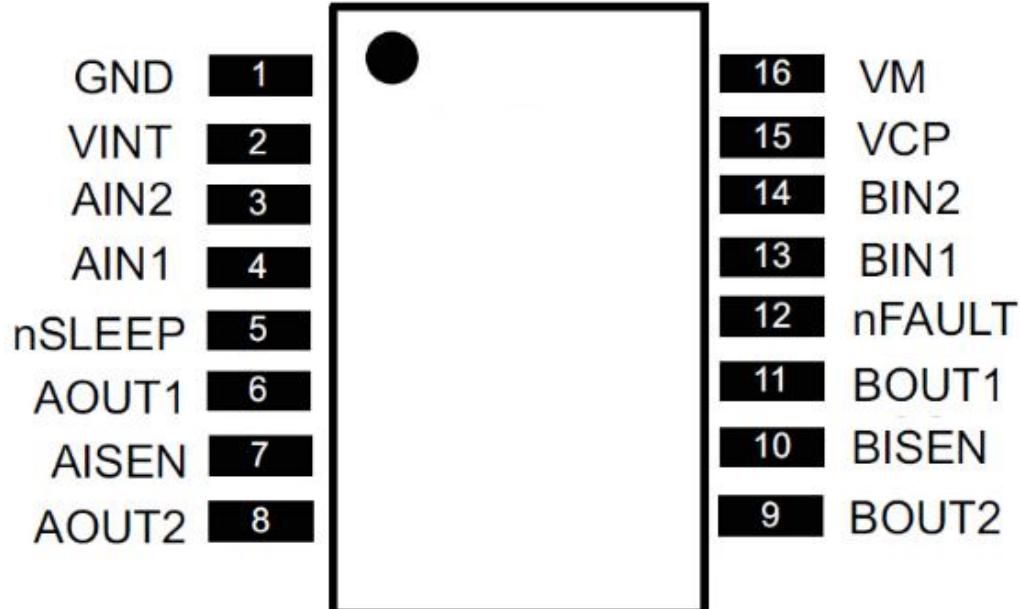
当内部电路结温超过 165°C 时，过温模块开始工作，关断内部多路驱动电路。过温保护电路只保护电路温度过高产生的问题，而不应对输出短路的情况产生影响。热关断的阈值窗口大小为 45°C。

## 管脚定义

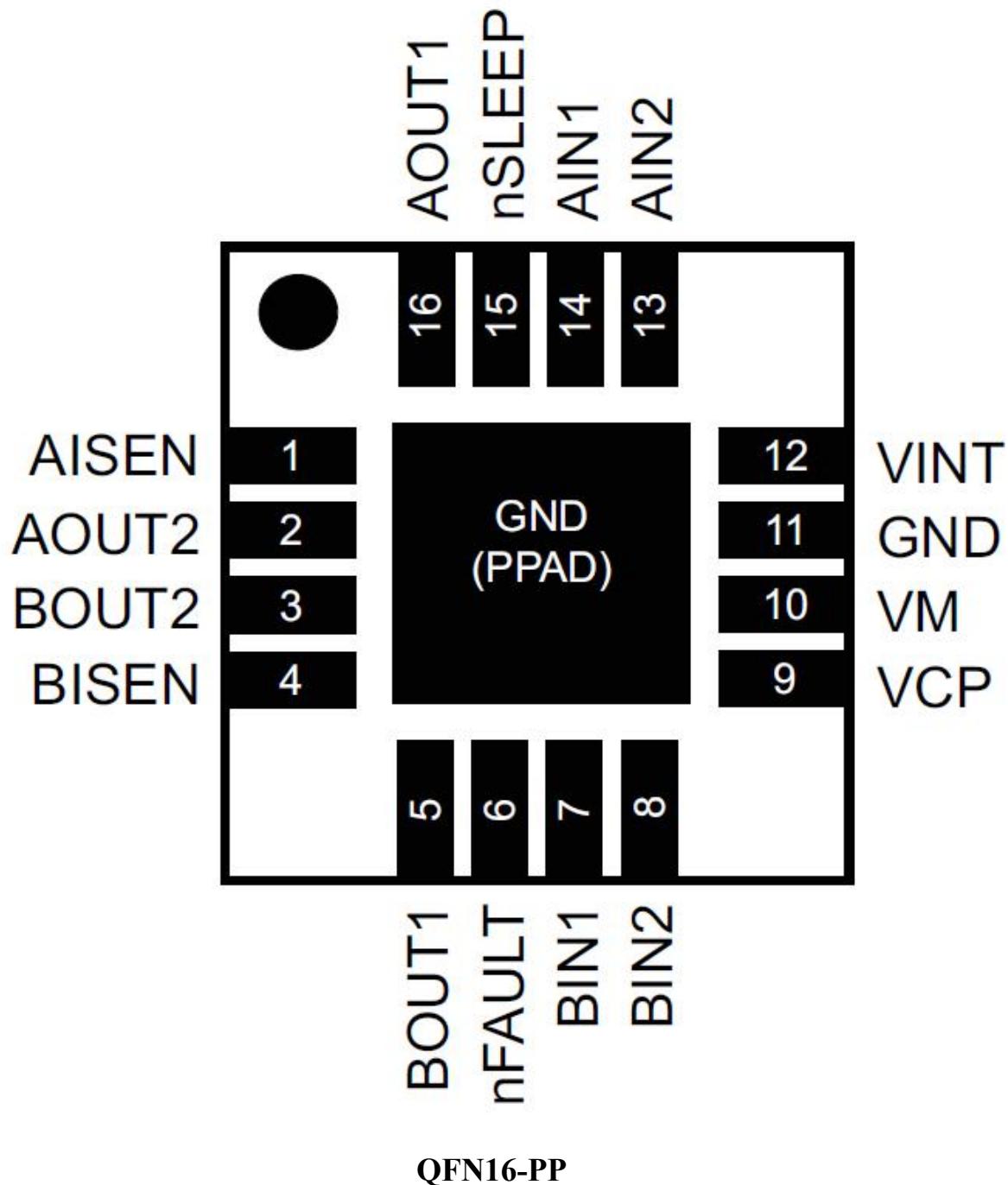
### TOP VIEW



### TSSOP16-PP



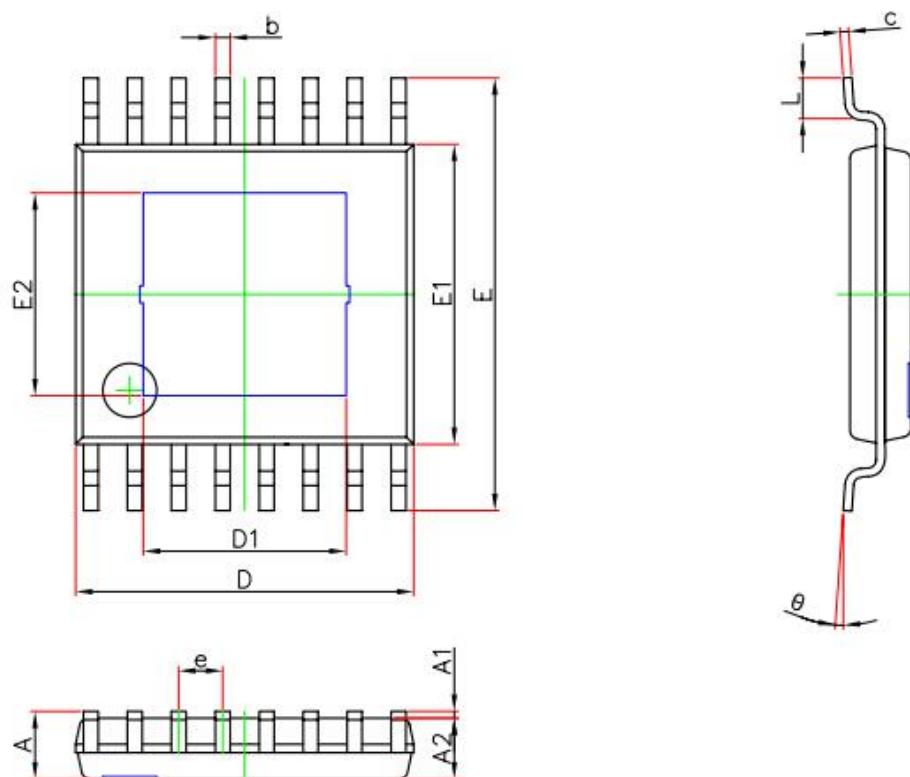
### SOP16



### 管脚列表

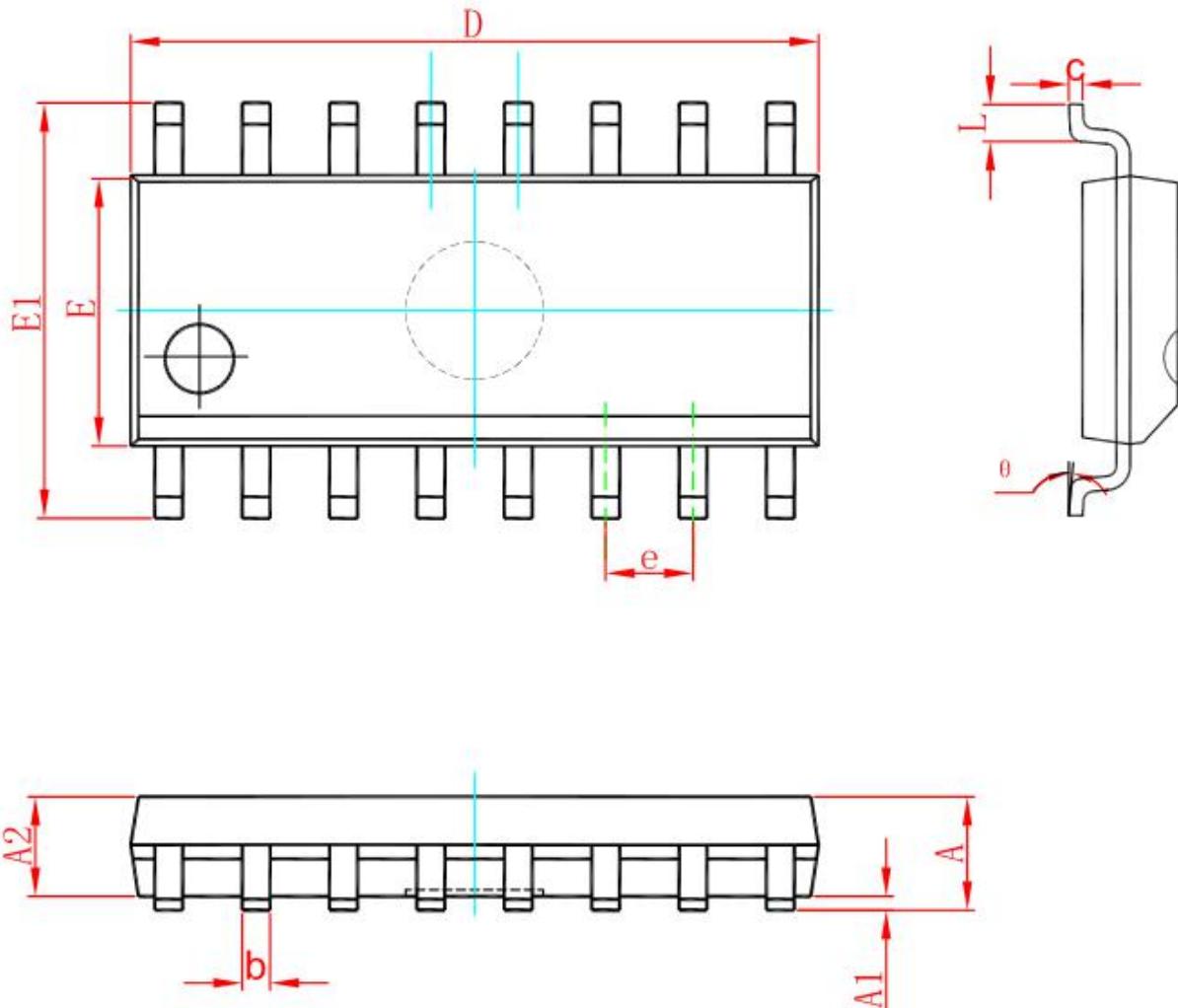
NAME	PIN			Pin Description	<b>EXTERNAL COMPONENTS OR CONNECTIONS</b>
	TSSOP	SOP	QFN		
<b>POWER AND GROUND</b>					
GND	13	1	11	器件地	所有地管脚和裸焊盘需连到系统地。
PPAD	-	无	-		
VM	12	16	10		电机电源，做好滤波，最小10uF电容到地。
VINT	14	2	12		接一个2.2uF电容到地。
VCP	11	15	9		接一个0.01uF电容到VM。
<b>CONTROL</b>					
AIN1	16	4	14	H桥A输入1	逻辑输入，控制AOUT1，内部下拉。
AIN2	15	3	13	H桥A输入2	逻辑输入，控制AOUT2，内部下拉。
BIN1	9	13	7	H桥B输入1	逻辑输入，控制BOUT1，内部下拉。
BIN2	10	14	8	H桥B输入2	逻辑输入，控制BOUT2，内部下拉。
nSLEEP	1	5	15	Sleep 模式输入	高电平使芯片正常工作；低电平使芯片进入休眠低功耗模式。
<b>STATUS</b>					
nFAULT	8	12	6	错误输出	当出现过温或过流时，输出低电平，开漏输出，使用需外部上拉。
<b>OUTPUT</b>					
AISEN	3	7	1	A组检流	A组检流，接检流电阻到地；若不使用检流，直接接地。
BISEN	6	10	4	B组检流	B组检流，接检流电阻到地；若不使用检流，直接接地。
AOUT1	2	6	16	H桥A输出1	接电机A组线圈
AOUT2	4	8	2	H桥A输出2	
BOUT1	7	11	5	H桥B输出1	接电机B组线圈
BOUT2	5	9	3	H桥B输出2	

TSSOP16 with exposed thermal pad



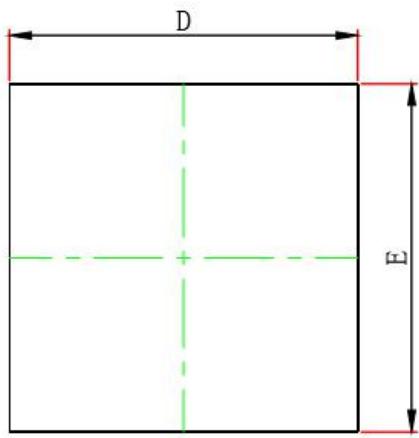
Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	—	1.200	—	0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.050	0.031	0.041
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
D	4.900	5.100	0.193	0.201
D1	2.900	3.100	0.114	0.122
E	6.250	6.550	0.246	0.258
E1	4.300	4.500	0.169	0.177
E2	2.900	3.100	0.114	0.122
e	0.650(BSC)		0.026(BSC)	
L	0.450	0.750	0.018	0.030
θ	0°	8°	0°	8°

SOP16

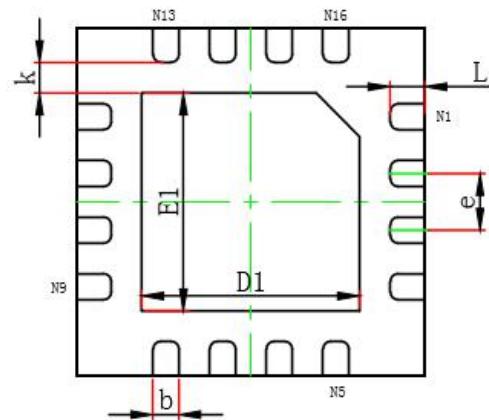


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	9.800	10.200	0.386	0.402
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

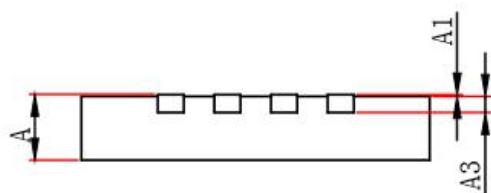
QFN16 with PAD



TOP VIEW



BOTTOM VIEW



SIDE VIEW

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.700	0.800	0.028	0.031
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.203REF.		0.008REF.	
D	3.900	4.100	0.154	0.161
E	3.900	4.100	0.154	0.161
D1	2.400	2.600	0.094	0.102
E1	2.400	2.600	0.094	0.102
k	0.200MIN.		0.008MIN.	
b	0.250	0.350	0.010	0.014
e	0.650TYP.		0.026TYP.	
L	0.324	0.476	0.013	0.019